

7003 智能 BGA-SMD 返修站

特点:

#可程式智能化拆焊、焊接参数、风咀温度的标准,以及三段温度焊接曲线的设置,使整个返修操作科学而有依据。



#完全无须手持的工作度,只须编程后触发即完成操作,BGA/SMD 元件得以受保护,免除损坏元件及 PCB 之可能。

#智能拆焊器与预热台的联机使用,使拆焊操作过程对 PCB 板、BGA 保护得更好。

#采用万能工作台架,方便夹持尺寸不一的 PCB,使焊接定位容易简单。933D 烙铁镊子智能互换焊台。更方便返修过程中对细小元件的操作,绝不殃及外围元件。

#配备专用之 BGA 拆焊、焊接风咀,使拆焊的质量更优异,操作更快捷。

#发热手柄与预热台的同步功能,使温度控制更精确,无须顾虑芯片超温损坏。

#先进的底部红外预热,160mm×160mm 高达1300W 预热功率,结合顶部 750W 热风功率,非常适合对大面积 PCB 的无铅制程返修。

#设计有气流量显示装置直观映出操作进的气流量变化。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

可准确检测到达BGA表面的温度[$\pm 3^{\circ}\text{C}$]

High precision $\pm 3^{\circ}\text{C}$ for measuring the temperature of BGA face



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)